



本社工場遠景（2024年4月移転）

- 本社所在地：静岡県沼津市
- 事業概要：半導体洗浄装置の樹脂躯体および部品を中心とした工業用樹脂加工業
- 常時使用する従業員数：国内67名（24年9月期）
- 現在の売上高：30億円（24年9月期）
- 法人番号：1080101001673
- Web：https://www.plaengi.co.jp

企業理念・100億宣言に向けた経営者メッセージ



代表取締役社長
増田 哲也

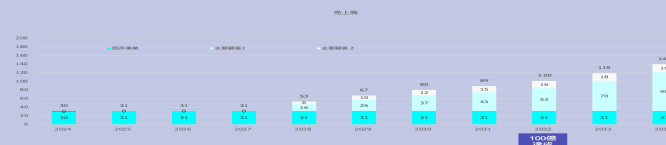
世界の半導体を支える技術の確立

プラエンジは、国内最大規模の樹脂溶接技術工を誇る樹脂加工業のトップリーダーとして、液晶や半導体の主に洗浄装置で産業に貢献してきました。当社にしかできない、手作業を要する溶接の微細加工技術力のさらなる高度化と生産能力の拡大で、日本の半導体産業のさらなる発展に貢献し、カーボンニュートラル化やデジタル化社会の実現と共にビジョンを実現します。また、海外子会社を合わせた全従業員とその家族が、幸せな将来像を描けるよう成長を続け、次世代の日本の中小樹脂加工業の地位を向上させます。

売上高100億円実現の目標と課題

実現目標

2032年の売上高達成に向け、グループ全体の生産能力の拡大と技術高度化で、主要顧客の高付加価値製品で参入障壁を構築。最先端半導体市場の成長と共に売上・利益率を拡大。



課題

- ・本社工場増築による、生産拠点の統合と効率化で生産能力を拡大し、主要顧客の増産要請に対応。
- ・最先端加工機導入で新たな高付加価値樹脂材の微細加工技術力を向上させ、次世代半導体用洗浄装置の製造依頼に対応。
- ・グループ全体の長期的視かつ積極的な人材採用と育成。
- ・樹脂同業者との連携で国内樹脂加工業全体の持続的成長を図る。

売上高100億円実現に向けた具体的措置

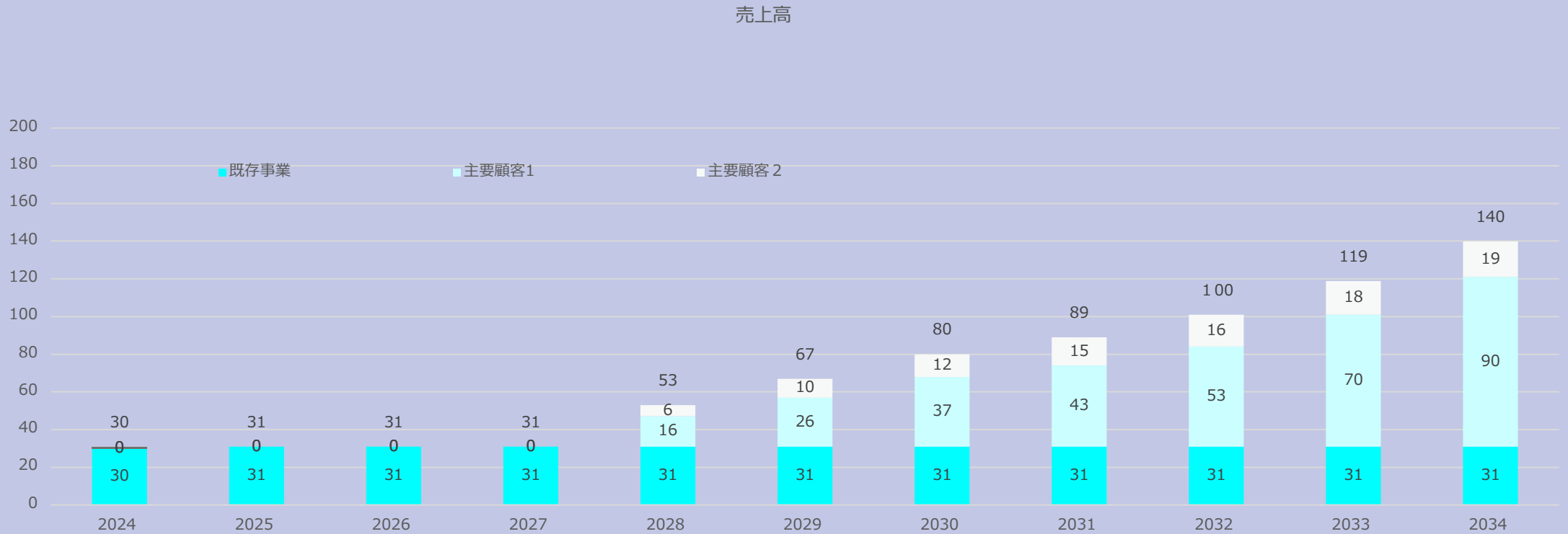
目指す成長手段

- ・工場増築した新本社工場体制で、分散している国内工場の集約とレイアウト変更で、生産能力拡大を図る。
- ・先端加工機を導入して生産能力拡張と、強みの溶接と組み合わせ技術高度化し、増産要請と高付加価値製品を受注する。
- ・フィリピン子会社含め、加工、溶接、検査で多様な人材の採用と育成、各部門長に権限移譲しさらなる増産体制を整備。
- ・同業樹脂加工会社とアライアンスやM&Aを通して、各企業の得意分野に応じた受注一本化を担い、業務効率化と高機能化を実現。

実施体制

- ・フィリピン子会社と国内の人員増でグループ全体の生産能力を最大限活かした、量産体制の確立。そのための人材育成。国内、フィリピン間の人事異動等の強化。全体の技術底上げ。
- ・フィリピン子会社含めたIT生産管理システム導入と共通化（工程管理・図面管理システム）による生産効率アップ。
- ・社長直轄の経営企画部を中心に、プロ人材を部門長とした、各部署や役職の役割、責任の明確化で権限委譲による意思決定の迅速化。各部門が連携して成長進捗を共有。
- ・アライアンス化→M&Aを見越した取引先との連携。

自由記載（例：売上高100億円実現に向けた具体的措置）



100億
達成